

中古半導体装置協会 (フォーム)

SEC/N.S1.FM.01.B

汚染除去申告書

セクション 1. 基本情報

基本情報:

装置所有者/販売者 _____ TEL: _____ 携帯電話: _____

会社名 _____ 会社住所 _____

装置使用場所 _____

装置/部品情報:

装置タイプ: _____ 製造元: _____ モデル番号: _____ シリアル番号: _____

供給社名: _____ アセンブリー番号: _____ キット番号: _____ 部品番号: _____

部品名: _____

装置概要: _____

生産しなくなった日付け: _____

この部品又は装置は有害物質にさらされましたか？ (適切な答えに丸をつけて下さい) はい (セクション 2 へ) いいえ (セクション 4 へ)

セクション 2. 装置プロセス/汚染情報

主要な部品が装置に関して、下記のカテゴリーに丸をつけて下さい。該当する全ての各カテゴリーに関する化学物質、副生成物又は概要をリストアップして下さい。(空白が足りない場合は裏面をご利用下さい。)

腐食剤 _____ ポンプオイル _____ 不活性ガス _____
溶剤 _____ DI Water/水 _____ (例: ナイトロジン、ヘリウム、アルゴン)
毒性ガス/自然発火 _____ 銅 _____ その有害物質:
砒素/ホウ酸/リン _____ 鉛 _____ (例: 蓄積されたエネルギー、磁力)
汚濁液 _____ 冷却材 _____ 電気関係、機械関係、空圧関係、など)
放射能物質 _____

セクション 3. 汚染除去申告書

該当する全てに丸をつけて下さい: この部品と装置は、下記の手順に従って汚染除去又はその用意をしましたか？

腐食剤で汚染された表面が pH テストで、5 から 9 間になりましたか？ (結果書類は裏面)	Yes	No	NA
フッ化物 (F) に汚染された表面のテストはしましたか？ (結果書類は裏面)	Yes	No	NA
拭き取ったサンプルはありますか？ (結果書類は裏面)	Yes	No	NA
全ての残留化学物質、残渣物、プロセス生成物は取りましたか？	Yes	No	NA
密封されていない全ての溶液はラインから取り除き空気で吐出しましたか？	Yes	No	NA
ガスシステムは、パーズと真空引きしましたか？	Yes	No	NA
全てのポートと開港口部分は OEM 認定又は同等のキャップかプラグで封をしましたか？	Yes	No	NA
装置と部品は、いかなる残留汚染物質に対しても最小の露出になるように梱包していますか？	Yes	No	NA

中古半導体装置協会 (フォーム)

SEC/N.S1.FM.01.B

汚染除去申告書

システム汚染チェックリストは用意/添付しましたか? (可能であれば)

Yes No NA

上記の項目で[No]を選択した場合は、下記にその概要を記述下さい。この部品又は装置の輸送又は移動に関しては、地方又は地域のEHS 代表者のサ署名承認が必要となるかもしれません。また、輸送は、機密、危険物扱いとなります。

概要: _____

注意事項: _____

危険物と (又は) その他の懸念をリストアップ要

汚染除去担当者名: _____

部門または会社名: _____ TEL: _____

署名: _____ 日付: _____

セクション 4. 署名

この書類を完成させ署名することによって、署名者は上記の装置構成部品は汚染されてなく、又は OEM と業界基準に従って汚染除去されたものとして認証したことになります。装置と (又は) 部品で、汚染除去ができない又はできなかったもので、危険物が残っているものに関しては下記のように分類した。

汚染物結果

お客様名: _____

作業場所: _____

装置モデルタイプ: _____

シリアル番号: _____

サンプル

サンプル番号	ロケーション	汚染除去 前/後	方法	結果
1		前		
		後		
2		前		
		後		
3		前		
		後		
4		前		

書類番号: SEC/N.S1.FM.01.A

Page 2 of 3

初版: 1/31/2004

最新版: 9/19/05

この書類の著作権は SEC/N. © に属しており、書類上の許可のない複写を一切禁じます。

中古半導体装置協会 (フォーム)

SEC/N.S1.FM.01.B

汚染除去申告書

		後		
		前		
5		後		
		前		
6		後		
		前		
7		後		
		前		
8		後		
		前		
9		後		
		前		
10		後		

コメント: